2023年3月期 (第21期) 決算説明会

2023年5月17日

株式会社ジーダット



1. 2023年3月期 決算概要

2. 2024年3月期 計画·業績予想

2023年3月期のポイント

売上高:20.1億円 (対前年比2.3%増)

営業利益:2.6億円 (同22.1%増)、経常利益:3.1億円 (14.8%増)

海外半導体市場向けの売上が伸長

国内FPD※市場向けの売上が縮小傾向

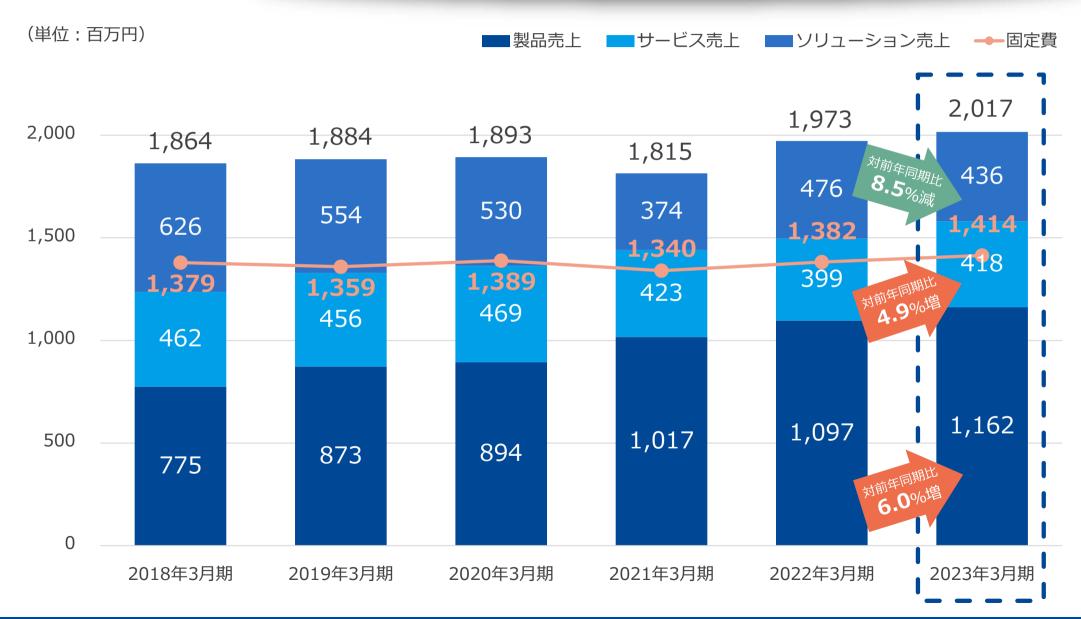
※ FPD: Flat Panel Display etc.

売上伸長+利益率向上+固定費堅調+α... で大幅増益

2023年3月期業績概要

(単位:百万円)	2022年3月期		2023年3月期			
	実績	売上高比	実績	売上高比	対前期比	
売上高	1,973	100.0%	2,017	100.0%	+2.3%	
売上総利益	1,264	64.1%	1,305	64.7%	+3.3%	
販売費及び 一般管理費	1,045	53.0%	1,038	51.5%	△ 0.7%	
営業利益	218	11.1%	267	13.2%	+22.1%	
経常利益	276	14.0%	317	15.7%	+14.8%	
当期純利益	169	8.6%	266	13.2%	+57.4%	

売上高・固定費の推移

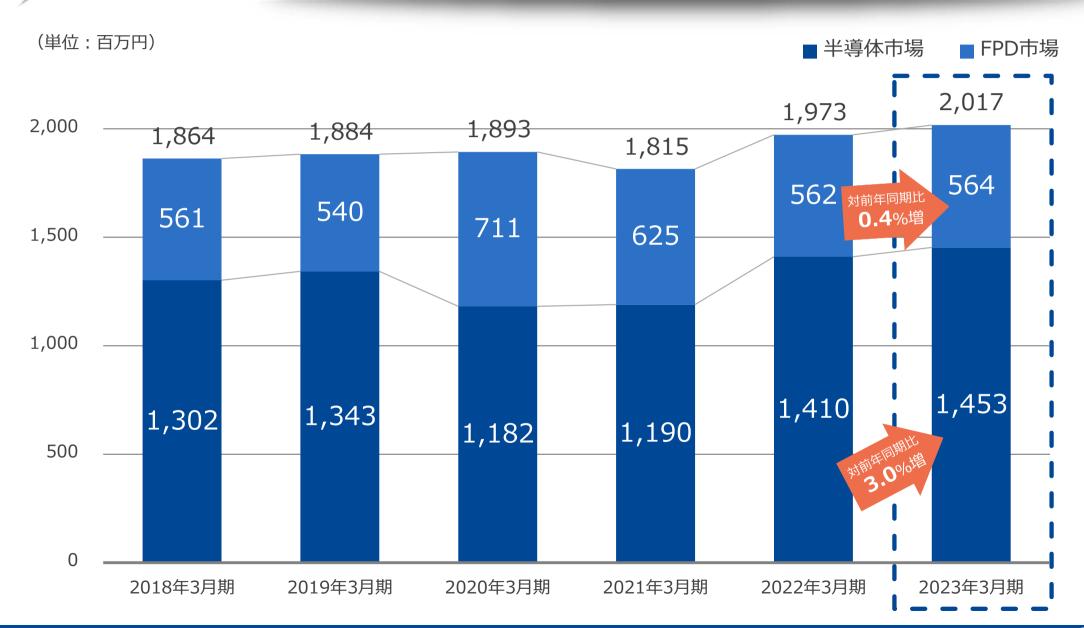


利益の推移

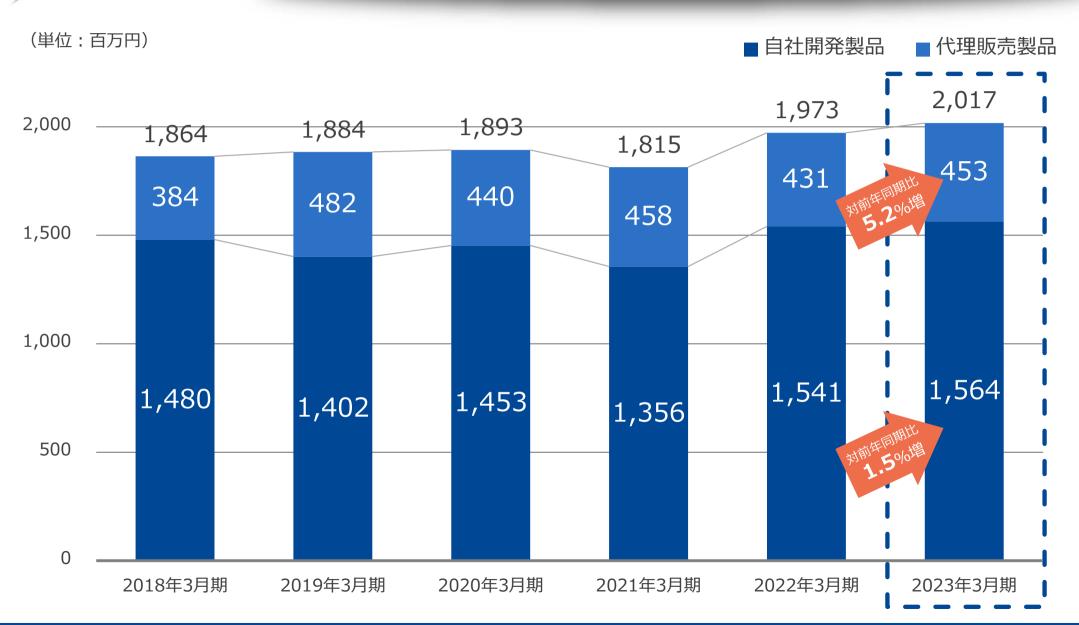


市場別売上高(半導体/FPD»)

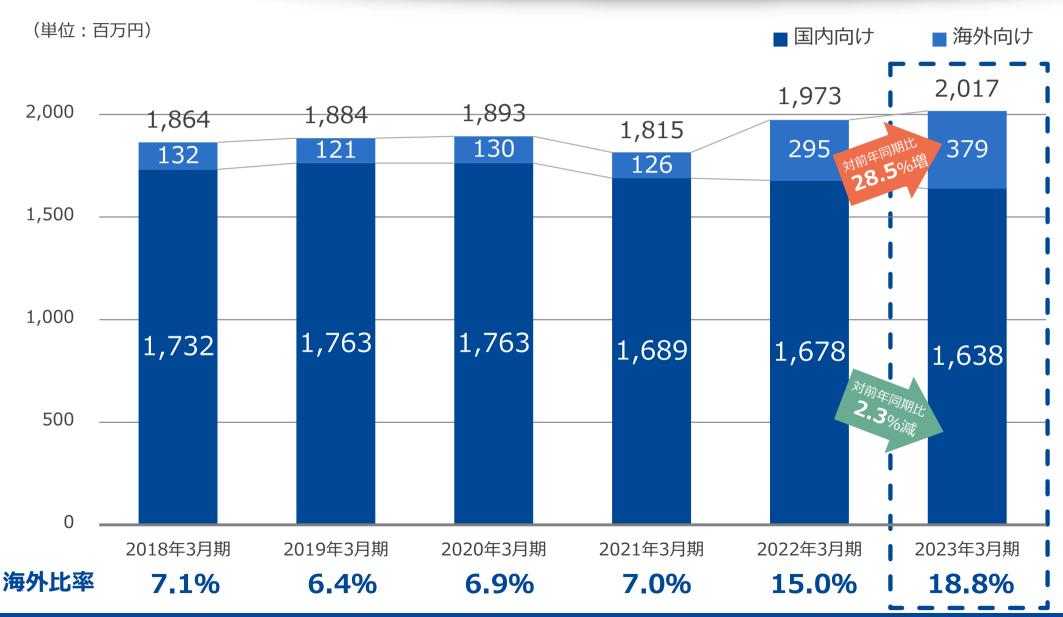
****** FPD : Flat Panel Display etc.



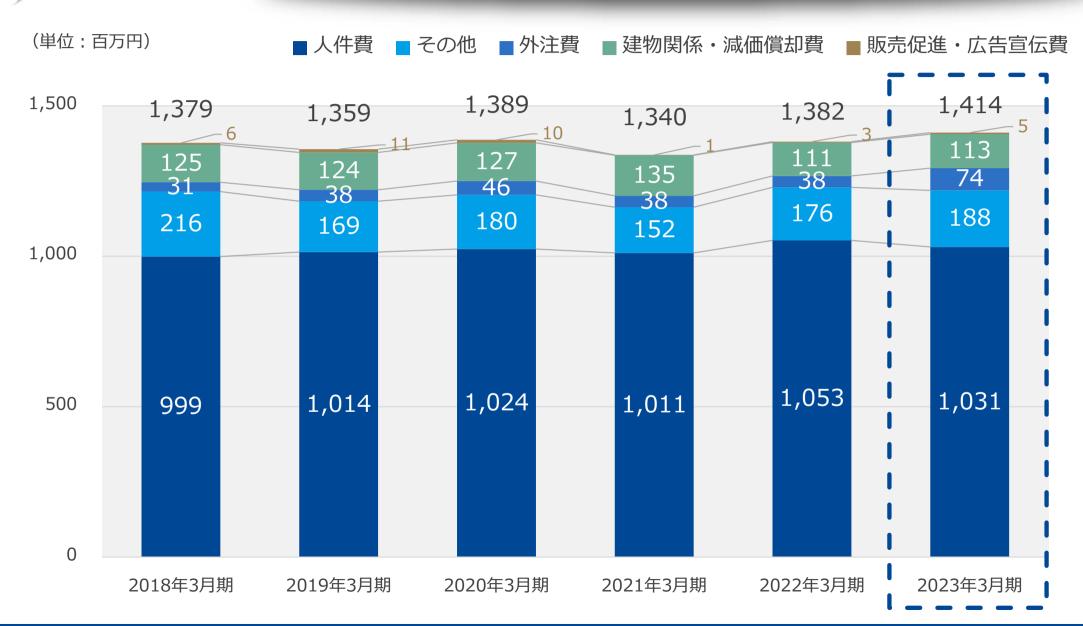
製品区分別売上高(自社開発/代理販売)



販売先別売上高(国内/海外)



固定費内訳



貸借対照表 – 前期末比 –

(単位:百万円)	2022年 3月末	2023年 3月末	差異		2022年 3月末	2023年 3月末	差異
(資産の部)				(負債の部)			
I_流動資産	4,055	4,180	124	I 流動負債	1,214	1,184	△ 29
1 現金及び預金	3,456	3,644	187	1 買掛金	107	115	8
2 受取手形		0	0	2 未払金	55	23	△ 31
3 電子記録債権	186	167	△ 18	3 未払費用	41	37	△ 3
4 売掛金	367	312	△ 55	4 未払法人税等	66	21	△ 44
5 仕掛品	3	_	△ 3	5 前受金	833	866	33
6 原材料	1	0	\triangle 1	6 預り金	16	10	△ 6
7 前払費用	23	37	14	7 賞与引当金	87	94	6
8 その他	17	16	\triangle 1	8 その他	7	15	8
				Ⅱ固定負債	6	3	△ 2
				資産除去債務	6	3	△ 2
				負債合計	1,220	1,188	△ 32
Ⅱ固定資産	275	310	34	(純資産の部)			
1 有形固定資産	45	31	△ 13	┃Ⅰ 株主資本	3,110	3,302	191
2 無形固定資産	6	22	16	1 資本金	761	762	1
3 投資その他の資産	224	256	32	_2 資本剰余金	892	893	<u> </u>
(1)投資有価証券	108	124	16	3 利益剰余金	1,485	1,675	189
(2)繰延税金資産	69	80	11	4 自己株式	△ 28	△ 28	
(3)その他	46	50	4	Ⅱ 新株予約権	0	_	\triangle 0
				純資産合計	3,110	3,302	191
資産合計	4,331	4,490	159	負債純資産合計	4,331	4,490	159

キャッシュフロー計算書 -前年同期比-

(単位:百万円)	2021年4月1日 ~ 2022年3月31日	2022年4月1日 ~ 2023年3月31日	差異
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	795	311	△ 484
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19	△ 52	△ 32
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 37	△ 74	△ 37
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1	0	△ 0
∨ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	739	185	△ 554
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,785	2,525	739
VII 現金及び現金同等物の四半期末残高	2,525	2,710	185

総資産・自己資本



12

トピックス

- ◆ 主力製品の機能拡張を継続
 - ◆SX-Meister Ver.14.0リリース
 - アナログLSIの設計自動化機能を更に拡充
 - 大型パネル向けの容量抽出ツールを新発売
- ◆ 代理販売品ラインナップの強化
 - ◆Simyog社(印), Baum社(韓), Maxeda社(台)
- ◆産官学連携の促進
 - ◆ 九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会に加入
 - ◆ AIを用いたアナログ回路合成研究開発プロジェクトに北九州 市立大学が加入

1. 2023年3月期 決算概要

2. 2024年3月期 計画・業績予想

2024年3月期のポイント

売上高:22億円 (対前年比9.0%増)

営業利益:2.9億円 (同8.6%増)、経常利益:3.2億円 (同3.3%増)

コア製品の競争力・販売力を強化 (アナログ,パワー向け)

海外半導体市場向け売上の拡大

デバイス設計受託サービスの増強

2024年3月期業績概要

(単位:百万円)	2023年3月期		2024年3月期		
	実績	売上高比	計画	売上高比	対前期比
売上高	2,017	100.0%	2,200	100.0%	+9.0%
売上総利益	1,305	64.7%	1,336	60.7%	+2.4%
販売費及び 一般管理費	1,038	51.5%	1,046	47.6%	+0.8%
営業利益	267	13.2%	290	13.2%	+8.6%
経常利益	317	15.7%	328	14.9%	+3.3%
当期純利益	266	13.2%	270	12.3%	+1.4%

電子デバイス業界の状況

◆ 半導体関連

- ◆世界的にシリコンサイクルの「谷間」に突入
- ◆一部車載向け等の分野は「品薄」傾向が継続
- ◆最先端向け分野には国が強力バックアップ

◆ FPD(Flat Panel Display etc.)関連

- ◆特に国内のFPD業界は厳しい局面へ
- ◆新技術パネル・異形表示パネルの研究開発は活況
- ◆半導体「後工程」分野の研究開発が活況へ

課題と施策(1)

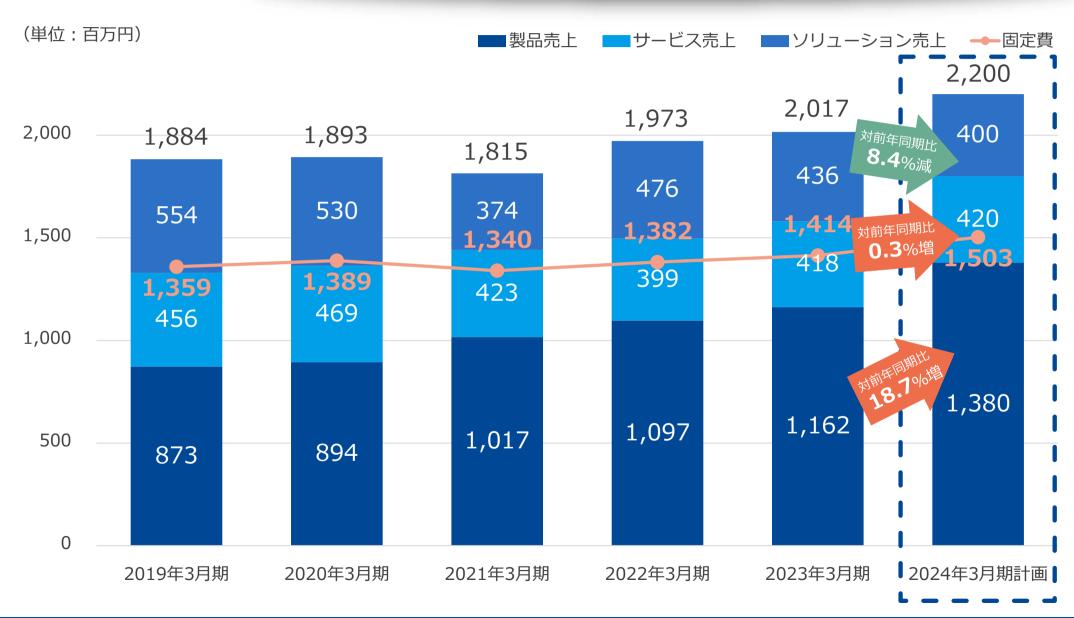
- ◆ コア製品の競争力・販売力を強化
 - ◆重点テーマに向けた開発を継続
 - ・ アナログLSI設計自動化環境(ACC)の拡張
 - パワーデバイス向け設計効率化機能の拡張
 - ◆研究開発活動の強化
 - ・ デバイス設計部門との連携強化 ⇒設計者目線の製品づくり
 - 外部技術の導入・活用を促進
 - ◆顧客との対話を促進・新顧客層の開拓
 - ・ 顧客の課題に寄り添う販促活動を展開
 - ハイブリッドからリアルへ軸足を移した活動を実施
 - 半導体製造装置、材料、後工程分野へ展開

課題と施策(2)

- ◆ 海外半導体市場向け売上の拡大
 - ◆ 大規模フォトマスクデータブラウザ: HOTSCOPE の販促活動を強化
 - ◆「プラットフォーム」戦略の促進

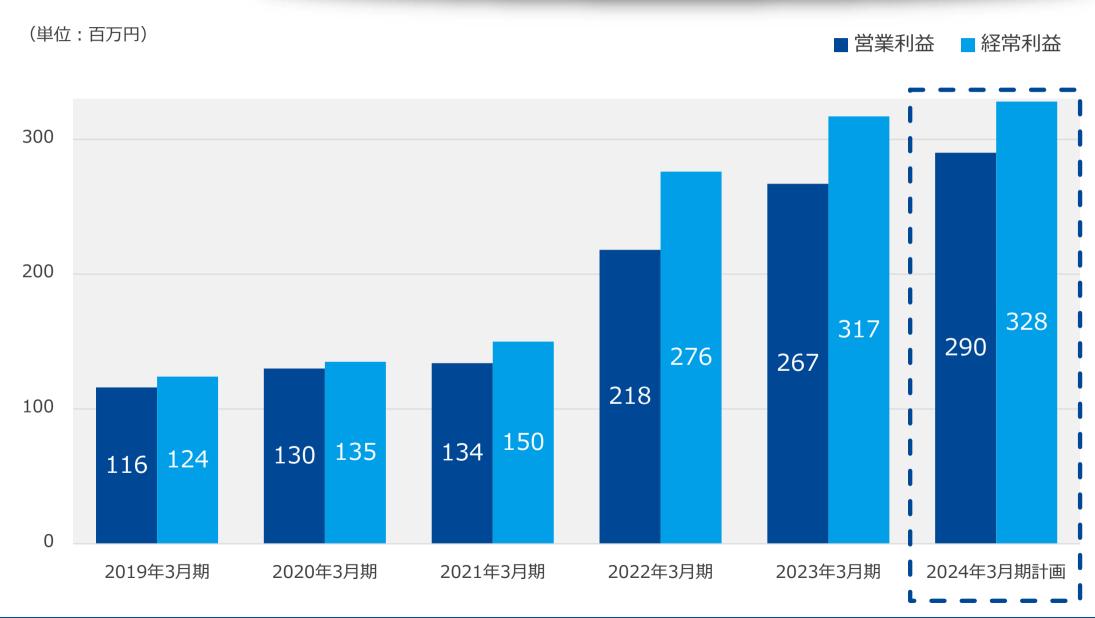
- ◆ デバイス設計受託サービスの増強
 - ◆重点顧客の深耕・拡張 ⇒業績安定性の確保
 - ◆ EDA開発との連携を強化 ⇒設計技術の具現化と蓄積
 - ◆新規顧客・新技術の開拓 ⇒成長路線に向けた布石

売上高・固定費の推移



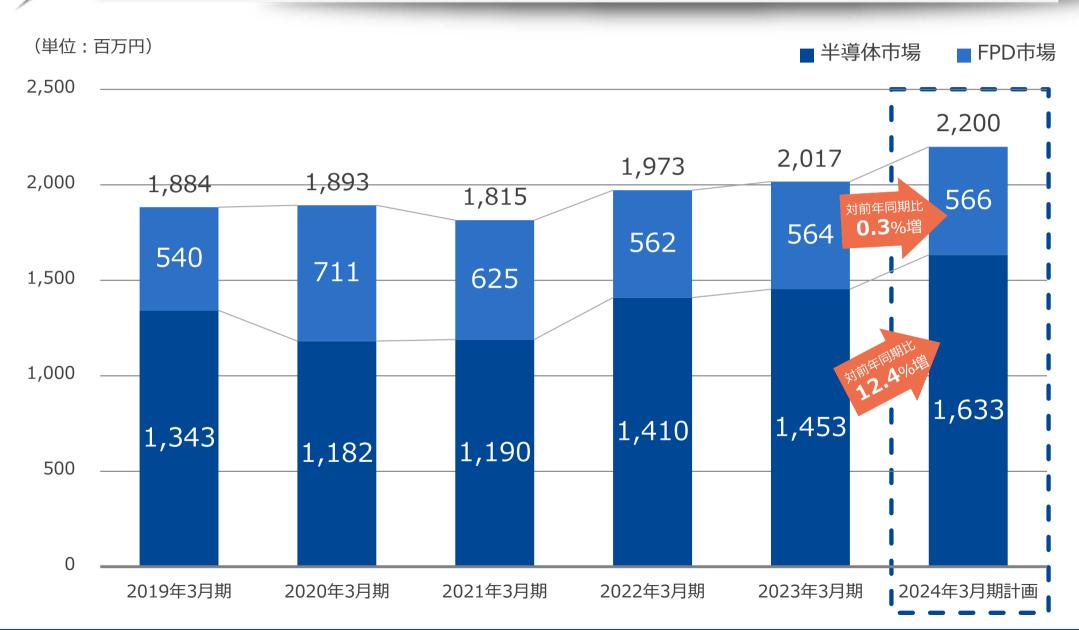
20

利益の推移

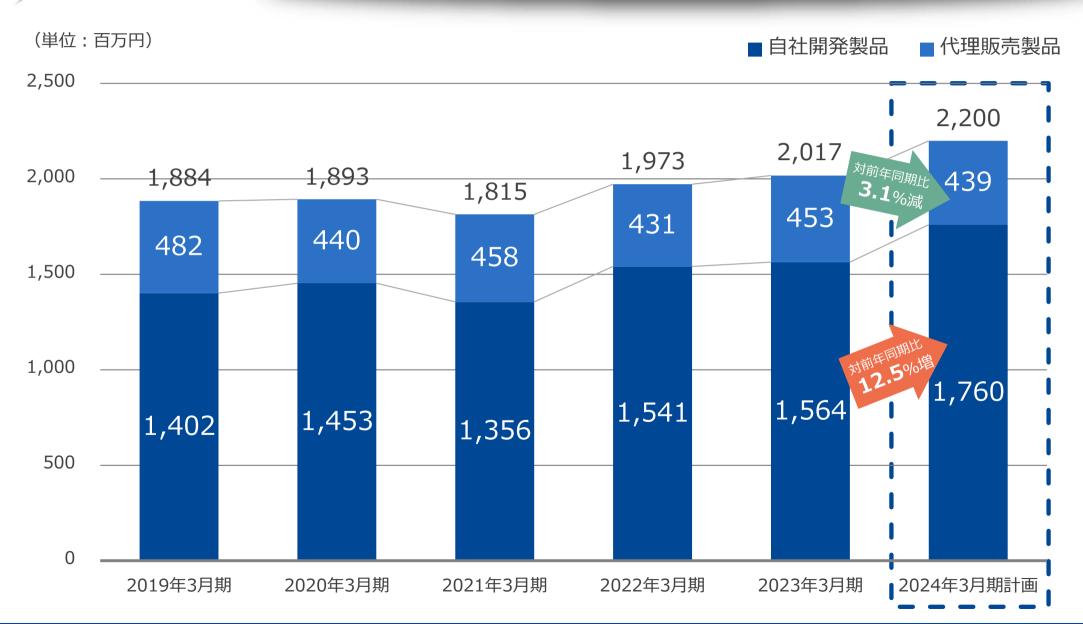


市場別売上高(半導体/FPD»)

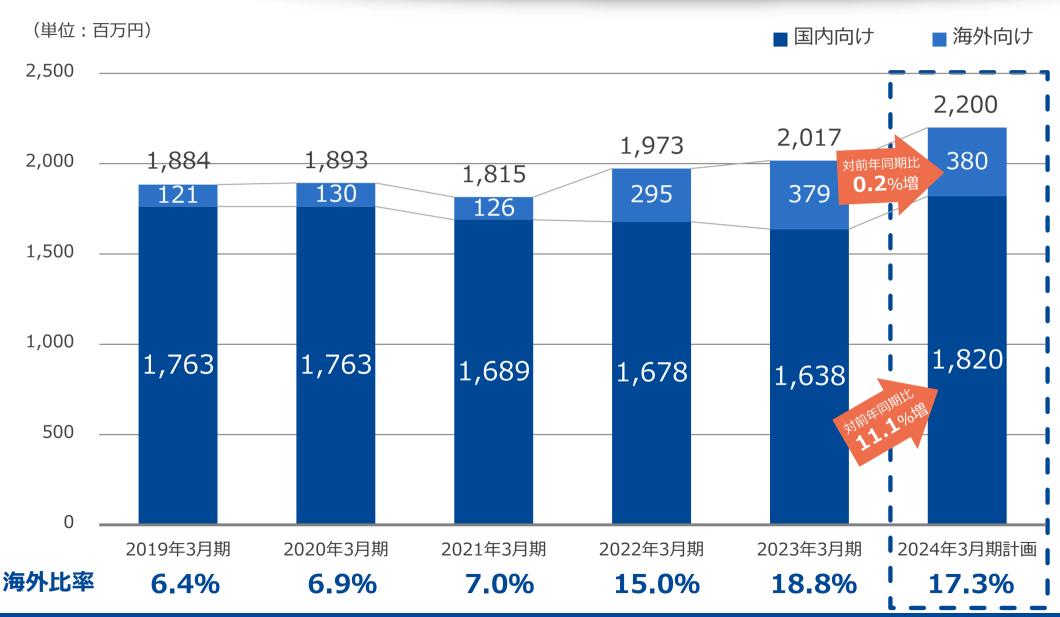
****** FPD : Flat Panel Display etc.



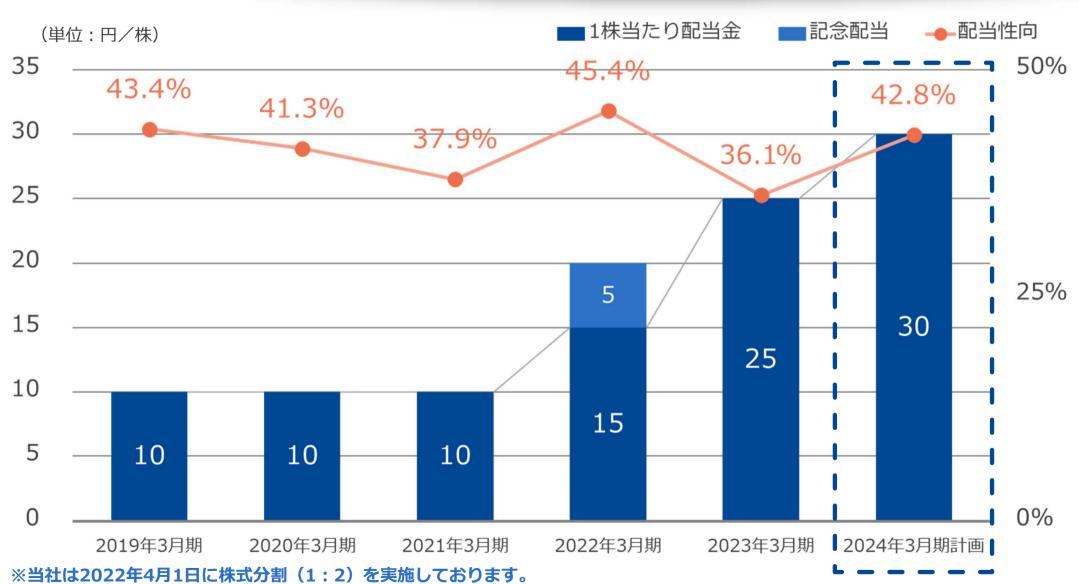
製品区分別売上高(自社開発/代理販売)



販売先別売上高(国内/海外)



株主還元:配当性向の水準を維持



[※]当社は2022年4月1日に休式万割(1:2)を美地してあります。
2022年3月期以前の1株当たり配当金は、比較のために株式分割後の数値で記載しております。

ご清聴ありがとうございました